# Tera Probe

## テラプローブ ビジネスレポート 2011

<sup>第7期</sup> 中間ビジネスレポート



# ごあいさつ

みなさまにはおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、心より厚く御礼申し 上げます。

また、東日本大震災で被災されたみなさまには、心 よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興 をお祈り申し上げます。

#### ■ 2011年度上期を振り返って

半導体業界においては、昨年から継続していたスマートフォンなどの需要の伸びが緩やかになったことを受け、今年度に入り製品の在庫が増加したことに伴い、メーカー各社で年初の生産計画を見直す動きが出てまいりました。

当社グループのテスト受託状況は、第1四半期については予想していた東日本大震災の影響はほとんど無く、堅調に推移いたしました。しかしながら、直近の第2四半期では、円高や欧州の財政危機の影響等による最終製品の市場環境の悪化に伴い、メモリ事業、システムLSI事業とも受託が減少傾向となりました。この結果、当上期における当社グループの売上高は前年同期比10.3%増の113億円となりました。営業利益は、前年度の設備投資による減価償却費増等により、同23.4%減の18億円となりました。

#### ■ 配当について

当社では、株主のみなさまに対する利益還元を経営 の最重要課題と位置づけており、企業価値向上とのバ



代表取締役社長兼CEO **渡辺 雄一郎** 

ランスに配慮しつつ、収益状況に応じた利益還元を行 うことを基本方針としております。

しかしながら、当期純利益が期初予想から減少する 見通しとなったため、10月26日の取締役会にて剰余 金の配当予定額(期末)を10円に変更させていただ くことを決議いたしました。株主のみなさまには深く お詫び申し上げます。

## ■ 今後の取り組み

10月1日より当社グループにテラミクロス社が加わり、WLP事業を開始いたしました。(P5~P7「トピックス」もご参照ください。)テスト事業に加えて、市場拡大が見込めるWLP事業をもう一つの柱とすることで、ターンキーサービスの充実を図ってまいります。

今後も、グループー丸となり全力を尽くして一層の ビジネス拡大に取り組んでまいりますので、引き続き で支援をお願い申し上げます。

#### 半導体製造工程におけるテラプローブグループの役割



※**ターンキーサービス**:水平分業化された半導体製造プロセスでは、顧客が各工程(ウエハテスト、パッケージング、ファイナルテスト)の仕様を決定し、発注先を決定、管理をする必要があり、業務が煩雑になってしまいます。

ターンキーサービスは、ウエハ製造後の各工程を当社グループがパートナーと密に連携、マネジメントし、一本のラインのように提供できるサービスです。これにより、顧客は製品出荷までの管理の省力化が可能となります。

#### ■ 半導体業界の繁栄を支えるテストビジネス

テラプローブでは、最先端のテスタ群を保有(メモリテスタ保有数国内No.1)し、世界トップクラスの多数個同時測定技術により単位時間あたりの処理能力を向上し、テストコストの削減を提案しています。また、幅広いデバイスに対応した豊富なテスタラインナップで、動きの早い半導体業界のニーズに応えます。

#### ■ ターンキーサービスで顧客の利便性向上に貢献

半導体は、高度な技術が求められるいくつもの工程を 経て製造されています。半導体業界では、各工程に特化 した専門業者がそれぞれの工程を担当し、一つの製品を 完成させる「水平分業」化が進みつつあります。

当社は、パートナー企業との協力体制を構築し、ウエハテストからパッケージング、ファイナルテストの全工程の窓口を一本化し、顧客の利便性を向上します。10月1日よりテラプローブグループに(株)テラミクロスが加わったことにより、さらにこれを強化していきます。

3

## トピックス

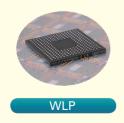
2011年10月1日より、(株) テラミクロスはカシオマイクロニクス(株)のWLP関連事業を承継し、テラプローブのグループ会社としてビジネスをスタートしました。

# Teramikros

# ウエハレベルパッケージ WLP(Wafer Level Package)とは?

半導体パッケージの一種で、パッケージの実装面積が半導体チップと同じ大きさになる<小型・薄型>を特長とするパッケージです。同じチップをパッケージした場合、従来の代表的なパッケージ(QFP\*)と比べると、サイズは10分の1程度となります。ウエハ状態でパッケージ最終工程までを完成させる製法で、高い技術力が求められます。モバイル機器の小型化、多機能化に伴い使用される電子部品のパッケージにも最小化が要求され、WLPの採用が進んでいます。

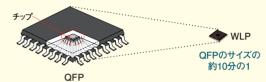
※右ページ①の図をご参照ください。



## WLPの特長

## ①究極の小型、薄型パッケージ

チップサイズと同じ大きさで、厚さは最薄220 ミクロン(0.22mm)

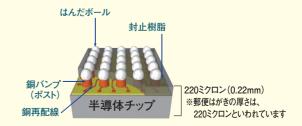


## ②プロセスの簡略化によるコスト削減



## テラミクロスのWLP

樹脂封止により、丈夫で厚い保護層が出来るので他社のWLPに比べて保護性能に優れる



5

#### WLP市場の見通し/今後の展開



WLP技術を使った半導体は、スマートフォン、携帯電話をはじめ、デジタルカメラ、携帯型ゲームなど、軽薄短小が求められる製品に幅広く使われています。

テラミクロスのWLP製品は他社製品に比べ耐久性などの面でお客様に高い評価をいただいています。

また、半導体チップを基板に内蔵する技術の開発も進めており、さらなる機器の小型化に貢献してまいります。 このように、成長の見込めるWLP市場において、高品質と技術力を武器にWLPのリーディングカンパニーを目指します。

#### WLPを利用した製品の例







## 事業拠点



#### \_\_\_\_\_ テラプローブグループの歩み

2005年 8月	エルピーダメモリ(株)のウエハテスト部門 を分社して設立
10月	広島事業所にてDRAM製品のウエハテスト 事業を開始
	開発センターにてテスト技術等の開発受託 を開始
2006年 9月	九州事業所を開設
2008年 8月	台湾に合弁子会社 TeraPower Technology Inc.を設立
2010年12月	東証マザーズへ上場
2011年10月	カシオマイクロニクス(株)のWLP関連事
	業を承継し、(株)テラミクロスとして
	事業を開始

# 連結財務諸表

# 業績ハイライト

連結貸借対照表	(単位:百万円)				
科目	前期末 (2011年3月31日)	<b>当上期末</b> (2011年9月30日)			
〈資産の部〉					
流動資産合計	14,698	11,448			
固定資産合計	35,626	35,975			
資産合計	50,325	47,424			
〈負債の部〉					
流動負債合計	15,516	11,968			
固定負債合計	8,251	8,213			
負債合計	23,767	20,182			
〈純資産の部〉					
株主資本合計	25,175	26,150			
その他の包括利益累計額	△281	△478			
少数株主持分	1,663	1,569			
純資産合計	26,557	27,241			
負債純資産合計	50,325	47,424			
連結損益計算書 (単位:百					

科目	<b>前上期</b> (2010年4月1日~2010年9月30日)	<b>当上期</b> (2011年4月1日~2011年9月30日)
売上高	10,224	11,279
売上原価	7,004	8,533
売上総利益	3,219	2,746
販売費及び一般管理費	805	897
営業利益	2,414	1,848
営業外収益合計	34	88
営業外費用合計	189	254
経常利益	2,259	1,683
特別利益合計	112	105
特別損失合計	103	30
税金等調整前四半期純利益	2,268	1,759
法人税等	465	689
少数株主利益	202	94
少数株主損益調整前四半期純利益	1,803	1,069
当期純利益	1,601	974

連結キャッシュ・フロー計算	(単位:百万円)	
科目	前上期 (2010年4月1日~ 2010年9月30日)	<b>当上期</b> (2011年4月1日~ 2011年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,363	5,252
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,198	△6,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,232	△218
現金及び現金同等物に係る換算差額	△40	△44
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	△107	△2,003
現金及び現金同等物の期首残高	2,820	7,211
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,713	5,207







純資産・総資産

純資産 総資産

# 会計概要 (2011年9月30日現在)

汁 名 株式会社テラプローブ (英文: Tera Probe, Inc.)

立 2005年8月

資 本 金 11.823百万円

従 業 員 302名(単体)、419名(連結)

事業内容 ●メ干リ事業

(DRAM等のメモリ製品のウエハテスト及び開発受託)

●システムLSI事業

(SoC、イメージセンサ、アナログ等 各種半導体製品の ウエハテスト、ファイナルテスト及び開発受託)

# 株主メモ

定時株主総会

設

毎年4月1日から翌年3月31日まで

毎事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内 剰余金の配当の基準日 期末配当金 3月31日

株式の売買単位 100株

公告方 法 公告方法は、電子公告とします。ただし、事故そ

> の他やむを得ない事由によって電子公告ができ ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL http://www.teraprobe.com/

株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社

事務取扱場所 東京都中央区八重洲二丁目3番1号

住友信託銀行株式会社 証券代行部

〒183-8701 東京都府中市日鋼町 1番10 郵便物送付先 住友信託銀行株式会社 証券代行部

会 先 0120-176-417(フリーダイヤル) 電話 照

# ホームページのご案内

当社では、株主・投資家の皆様にプレス リリースや決算説明資料などのIR情報 をホームページにて公開しております。 是非、ご覧ください。

テラプローブ





#### 株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17

TEL:045-476-5711

ホームページアドレス http://www.teraprobe.com/